90 911 HI 804 035 D (1516)





90 911: Baugruppenträger mit Busplatine

für (Ex)i-Baugruppen des HIMA Planar4 Systems

Anschlüsse: Löttechnik

Getrennte Spannungszuführung zu jedem Steckplatz



Lieferung ohne Baugruppen

Bild 1: Baugruppenträger

Der Baugruppenträger wird nur für das HIMA Planar4 System eingesetzt. Auf den Steckplätzen 1...20 können beliebige Baugruppen des Planar4 Systems gesteckt werden, Platz 21 ist für die Kommunikationsbaugruppe reserviert.

Die Busplatine auf der Rückseite enthält Federleisten, Anschlussleisten (Löttechnik) und die für eine Funktion notwendige Busstruktur:

- Verbindungen für die interne Kommunikation
- Spannungsversorgung EL+ (24 VDC) zu jedem Steckplatz
- L- für alle Steckplätze
- Sammelschiene und Kontaktschleife für die Fehlersignale.
- Für das Datenverbindungskabel der Kommunikationsbaugruppe ist eine Durchführung nach hinten auf die Verdrahtungsebene vorhanden.

Der Baugruppenträger ist komplett montiert einschließlich Beschriftungsfeld vorn sowie Verdrahtungsschutzhauben und zwei Verdrahtungskanälen auf der Rückseite.

HI 804 035 D (1516) 90 911

Material Aluminium, chromatiert
Breite 482,6 mm (19 Zoll)
Höhe 177 mm (4 HE)

Tiefe 270 mm

Teilungseinheiten 84 TE (1 TE = 5,08 mm)

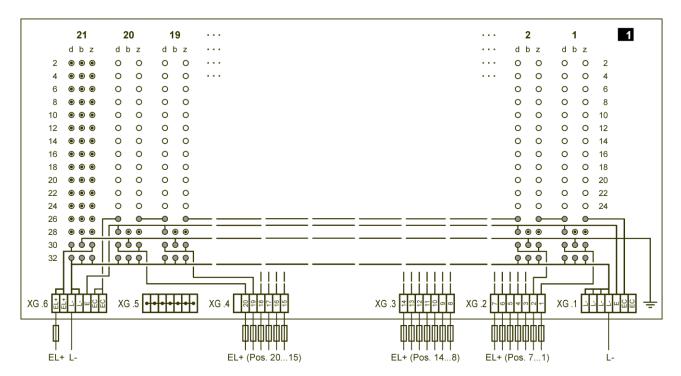
Baugruppen Nach DIN 41494, jeweils 4 TE

Steckverbinder Nach DIN 41612, Bauform F, mit Reihen z und d

Anschlussart Löten
Masse Ca. 3,5 kg

Prinzip der Busplatine

Ansicht von der Rückseite



1 Steckplatznummer

- E Schiene für Fehlersignal ERR
- Anschluss für Funktionsverdrahtung
- EC Kontaktschleife für Fehlersignal

- Verbindung auf Busplatine
- belegt für Kommunikation

Bild 2: Busplatine des Baugruppenträgers, EL+ für jeden Steckplatz Prinzipdarstellung

Der Anschluss der Versorgungsspannung EL+ erfolgt einzeln für jeden Steckplatz über die Steckklemmenblöcke XG .2 bis XG .4 bzw. XG .6 (nur Kommunikationsbaugruppe).

Aus Sicherheitsgründen muss der Bezugspol L- von zwei getrennten Klemmen der Verteilung L- auf beiden Steckklemmenblöcken XG .1 und XG .6 angeschlossen werden (Ringleitung).

Die weiteren Anschlussklemmen für L- auf XG .1 und XG .6 sollten nicht zur Speisung weiterer Baugruppenträger verwendet werden, um hohe Summenströme zu vermeiden.

Der Steckklemmenblock XG .5 ist potentialfrei; die Anschlussstifte des Blocks sind auf der Platine gebrückt. Der Block kann nach Bedarf verwendet werden.

Für die Versorgung von Leistungsausgängen über den Steckklemmenblock XG .5 sollen für L+ und L- eigene Versorgungsleitungen mit geeigneten Querschnitten verwendet werden (siehe

90 911 HI 804 035 D (1516)

auch Kapitel «Verdrahtung der Baugruppenträger» im Systemhandbuch). Die Strombelastung ist auf max. 16 A begrenzt.

Um die mechanische Belastung der Lötstellen an den Anschlussstiften gering zu halten, sollten die Steckklemmenblöcke zum Anschließen oder Entfernen von Drähten aus der Fassung herausgezogen werden.

Die Erdungsanschlüsse b30 sind mit den Metallteilen des Baugruppenträgers elektrisch leitend verbunden. Die Anschlüsse z28, b28, d28, z30...d32 der rückseitigen Anschlussleisten sind nicht mit der Busplatine verbunden.

Bei Verwendung der Kontaktschleife für das Fehlersignal müssen die Anschlüsse z26-d26 auf nicht benutzten Steckplätzen gebrückt oder mit einer der Klemmen EC verbunden werden.

Anschlussleisten (Ex)i 28-polig, Teile-Nr. 52.002 8420

Codierstift Teile-Nr. 52.000 0458

Wird auf die Möglichkeit der Datenübertragung verzichtet, können für das Planar4 System auch Standard-Baugruppenträger mit 28-poligen Federleisten verwendet werden.

HI 804 035 D (1516) 90 911